

Edge Protection™

Amkorは、MLF®パッケージの堅牢性をさらに向上させるため、テストや表面実装（surface mount assembly : SMA）などのハンドリング中にデバイスのエッジを保護するEdge Protectionテクノロジーを開発しました。

Edge Protection Technology Considerations

Amkorのパッケージ保護技術が、テストおよび組立プロセスや搬送中のMLF®パッケージのエッジを保護します。

Advantages

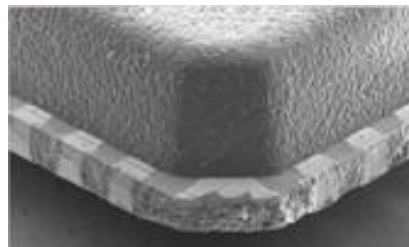
- ▶ パッケージのコーナーとエッジを通常比2倍以上強化
- ▶ テスト起因のダメージを低減
- ▶ ハンドリング時の損傷を低減
- ▶ パッケージ面積の変更なし

AmkorのMicroLeadFrame®パッケージは、1990年代の量産開始以来、サイズ面でのメリット、堅牢な品質、ウェットプルフラック構造により、自動車向け製品への採用が加速しています。Amkorは、MLFパッケージを自動車産業の厳しいニーズに対応するパンチ（Punch）タイプとソー（Saw）タイプで提供し、自動車向けQFNパッケージの主要サプライヤーとして高い評価を受けています。

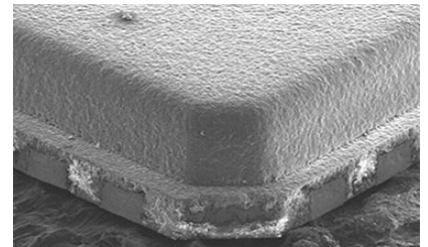
Amkorは、自動車アプリケーションの課題に対応する高品質QFNパッケージングソリューションのリーディングカンパニーとして、MLFパッケージソリューションの機能や能力を拡大する為の開発を続けています。実績あるディンプルエンドリード技術により、パンチタイプのMLFは自動車アプリケーションの選択肢として引き続き採用されています。

Amkorの革新的なEdge Protection Technologyは、パッケージデザインの堅牢性を向上させるため、特にテストプロセスで急速に採用が拡大しています。パンチタイプのMLFパッケージのエッジを強化することにより、テストプロセスでのパッケージダメージが大幅に減少しました。

Amkorは現在、様々なボディサイズのEdge Protectionテクノロジーを備えたパンチタイプMLFパッケージを提供しています。



Edge Protection™なし



Edge Protection™あり

詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。



本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたは係情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、如何なる保証も致しません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じた如何なる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によって如何なる特許またはその他のライセンスも許諾致しません。本文書は、如何なる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、如何なる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. TS112B Rev Date: 08/19